

# 迫りくるAI時代に向けた半導体製造プロセスの今

●発行 2019年5月 ●定価 54,000円 + 税 ●体裁 B5判ソフトカバー 259ページ

## ★AI技術の躍進で活用の幅が広がる半導体、最新技術動向を知る!★

ディープラーニング等人工知能への利用に求められる半導体デバイスとは?  
AIへの搭載を考えたとき製造プロセスには何が求められるのか?最新の装置動向は?

## ★3D-NAND や FOWLP、微細化への動きなど最新プロセスを網羅★

高性能化へ向けた技術進歩をしっかりと解説!現時点で技術はどこまで進んでいるのか?

## ★AI・データ科学による半導体製造プロセスの革新★

製造プロセスへのAI活用は?検査へのデータ科学の活用は?開発スピードがはやまる中、  
従来通りのやり方では追い付けない!新しい考えを導入して新時代に備えよう

## ★各製造プロセスの実務ポイント、最新動向もしっかりおさえる★

ALD成膜やEUV・DSA・NIL、原子層エッチングから枚葉式洗浄等最新技術を網羅!  
品質向上に向けた成膜のポイントは?CMP・研磨のポイントは?パターン倒壊を防ぐ洗浄とは?  
3次元集積の課題とは?信頼性評価の種類は?実務に必要な各プロセスの重要事項も解説!

## ★東京エレクトロン、東芝メモリ、NVIDIA他時代の先端を走る各社が執筆!

## 半導体製造プロセスの今を知ろう★

☆☆内容の詳細目次はHPに掲載しております!ぜひご確認ください☆☆

「情報機構 BC190501」と検索! または <https://johokiko.co.jp/publishing/BC190501.php> 迄

### 執筆者一覧【敬称略・順不同】

- 厚木エレクトロニクス 加藤 俊夫
- 東京エレクトロン 鄭 基市
- グローバルウェーブ・ジャパン 須藤 治生 永井 勇太 泉妻 宏治
- NVIDIA 馬路 徹

- 産業技術総合研究所 原 史朗
- ソメイテック 大藪 剣吾
- PICOSUN JAPAN 八尋 大輔
- 大阪大学 遠藤 政孝
- 日立製作所 篠田 和典
- ISTL 磯部 晶
- 茨城大学 周 立波

- オフィスシラミズ 白水 好美
- 東芝メモリ 柿沼 英則
- イーヴィグループジャパン 山本 宏
- 東芝メモリ 江澤 弘和
- 芝浦工業大学 二川 清
- オムロン 中村 芳行

FAX : 03-5740-8766、または、→<https://www.johokiko.co.jp> にて

### ★書籍申込書

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

(書籍申し込み要領)

- ◎右記記入の上、FAXでお申込を承ります。
- ◎お申込書を確認次第、書籍、請求書および振込要領をお送りいたします。
- ◎未発刊の書籍をお申込の場合、申込書を確認次第、受領書をお送りいたします。発刊時に弊社より書籍、請求書および振込要領をご送付いたします(送料は弊社負担)
- ◎お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込にてお願いいたします。原則として領収証の発行はいたしません。
- ◎振り込み手数料はご負担ください。
- ★ <https://www.johokiko.co.jp/> の申込みフォームからも承ります!

書籍名 HP【BC190501】		冊数 ____冊 ※記入の無い場合は1冊
迫りくるAI時代に向けた半導体製造プロセスの今 書籍		
会社名		
所属部課・役職等		
申込者氏名	TEL	FAX
E-MAIL	上司役職・氏名	
住所〒		
備考		
ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可) <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> 郵送		